

ATM-12100

全自動ウェーハマウンター Full-Automatic Wafer Mounter

【概要 - Outline -】

- ◆本機は、ダイシング前工程としての専用フレームへのウェーハマウント及びウェーハ保護テープの剥離を全自動で行う装置です。
This machine, adaptable for in-line operation, mounts a wafer on a frame before dicing and removes the protective tape laminated on a wafer.
- 粘着テープ上にウェーハを高精度に位置決めしマウントします。マウント終了後、ウェーハの表面保護テープを剥離します。
Wafer is accurately-aligned and mounted on adhesive tape. After mounting, the protective tape is peeled from the wafer.
- 剥離の終了した専用フレームは、搬出されてフレームマガジンへ収納されます。
Then, the wafer on a frame is unloaded and stored in a frame magazine.

【特長 - Features -】

- ◆真空チャンバー減圧方式により気泡のない貼り付けが可能です。
Vacuum chamber de-pressurization method enables bubble-free lamination
- ◆表面保護テープ剥離機構内蔵
Built-in BG tape removal mechanism
- ◆独自のロボットハンドで反りウェーハにも対応 (オプション)
Unique robot hand can handle warped wafers (Option)
- ◆プロトス供給、DAF に対応可能 (オプション)
Protos supply and DAF lamination are available (Option)



仕様 Spec	ATM-12100	
スループット Throughput	50 枚/h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	8・12 inch	
フレームサイズ Frame Size	2-8-1 / 2-12-1	
対応テープ幅 Tape Width	8 inch : W 300 mm / 12 inch : W 400 mm	
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC200V ±10% 3相 (3phase) 50/60Hz 10.0KVA
	空気源 air	圧力 (Pressure) 0.6~0.8Mpa
装置寸法 Demension	W 2,040 × D 2,600 × H 1,830 mm	
重量 Weight	2,600 kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.